

型番	抵抗	シート抵抗	抵抗	対応基板	対応電極	推奨焼成条件
Type	成分	/膜厚	温度係数	Substrate	Electrode	Sintering schedule
		resistance / thickness	TCR (ppm/°C)			
CN01DH	CuNi	10mΩ/□ /20μm	+500	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CN03DH	CuNi	30mΩ/□ /20μm	-100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CNR10H	CuNi	100mΩ/□ /20μm	<±100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CNR50H	CuNi	500mΩ/□ /20μm	<±100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CN1R5H	CuNi	1.5Ω/□ /20μm	<±100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CN3R0H	CuNi	3Ω/□/20 μm	<±100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
CN6R0H	CuNi	6Ω/□/20 μm	<±100	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
LB3s	LaB <sub>6</sub>	3Ω/□/20μm	<±350	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	850 °C 10min In N <sub>2</sub>
LB10s	LaB <sub>6</sub>	10Ω/□/20 μm	<±200	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	850 °C 10min In N <sub>2</sub>
LB100s	LaB <sub>6</sub>	100Ω/□ /20μm	<±50	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	850 °C 10min In N <sub>2</sub>
LB1ks	LaB <sub>6</sub>	1kΩ/□/20 μm	<±50	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu	850 °C 10min In N <sub>2</sub>
LB20sNE	LaB <sub>6</sub>	20Ω/□/20 μm	<±250	AlN	Ag	820 °C 10min In Air
LB100sNE	LaB <sub>6</sub>	100Ω/□ /20μm	<±100	AlN	Ag	820 °C 10min In Air
LB1ksNE	LaB <sub>6</sub>	1kΩ/□/20 μm	<±50	AlN	Ag	820 °C 10min In Air

シリーズ	型番	用途/特徴	対応基板	推奨焼成条件	塗布方法
Series	Type	Application and Characteristics	Substrate	Sintering schedule	Coating method
—	OCG02	オーバーコートガラスペースト 鉛フリー、耐めっき性良好 Overcoat glass paste, Lead-free Excellent resistance to acid, gray	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	650 °C 10min In N <sub>2</sub>	スクリーン印刷 Screen printing
—	OCG10	オーバーコートガラスペースト 鉛フリー、耐めっき性良好、透明 Overcoat glass paste, Lead-free Excellent resistance to acid, Clear	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	850~900 °C 10min In N <sub>2</sub>	スクリーン印刷 Screen printing